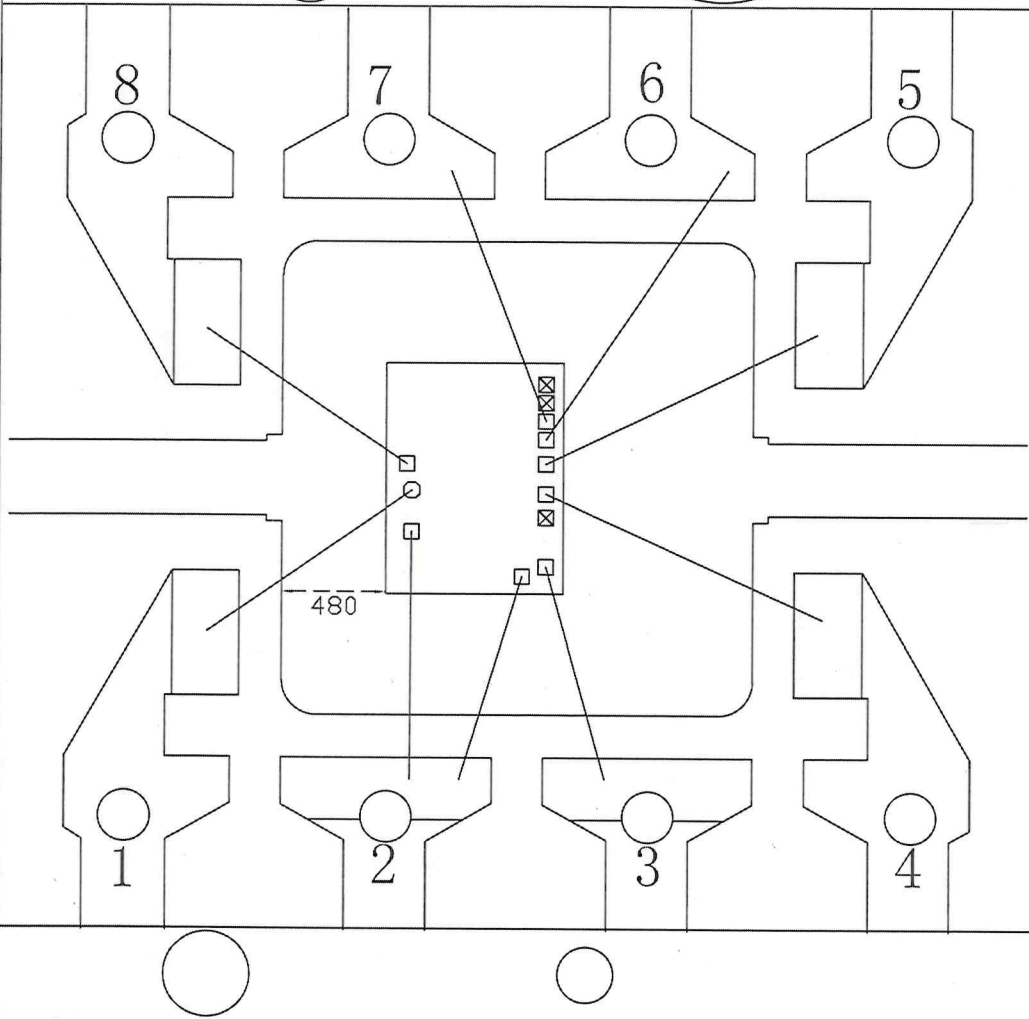
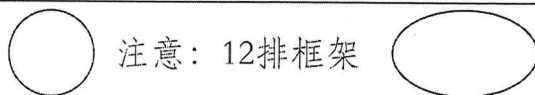




池州华宇电子科技有限公司
CHI ZHOU HISEMI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

| | | | |
|---------|----------|---------|---------------|
| (1)客户代码 | 008 | (2)焊线图号 | HT-PX-008-248 |
| (3)产品型号 | HS2245PT | (4)版本 | A |
| (5)芯片名称 | HS5132 | (6)封装形式 | SOP8L(12R) |

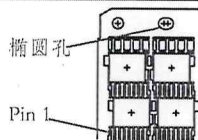
(7) Bonding Diagram



(8)特殊要求:
DB注意: 芯片上下居中放置

(9)实物芯片图:

(10) D/A Loading 方向:



(11) 1.WB如使用铜线, 需先确认PAD下是否有线路, 如有线路, 建议PAD铝层大于3um
2. 如没有线路, 建议PAD铝层厚度大于1.2um

| | |
|---------------|---------------------|
| (12) PAD下有电路: | (13) PAD铝垫厚度: 1.0um |
| PAD下无电路: | |

| | | | |
|------|--|---|---|
| 芯片尺寸 | 1069*825um ² (42.09*32.48mil ²) | (14) 引线框架 | SOP8-12R 90*90mil ² (2286*2286um ²) |
| 衬垫尺寸 | 70um*70um | (15) 装片胶 | 导电胶 S210N |
| 衬垫间距 | NA | (16) 线材 | 合金丝 |
| 焊线总数 | 9根 | (17) 焊线规格 | 20um |
| 劈刀型号 | UTS-28DC-AZM-1/16-XL-E | (18) 塑封料(Green) | 首选: EMG-600-2 备选: CEL-1702HF |
| 制图 | 2020.9.29 | (19) 磨片厚度 | 300um |
| 审查 | 2020.09.29 | 客户确认签字/盖章:(确认1~19项内容, 装片方向位置及焊线连接是否正确.) | |
| 核准 | 2020.9.30 | | |
| 制图日期 | 2020.09.29 | | |
| 生效日期 | 2020.9.30 | *免责声明: 图纸为产品下线生产的唯一依据, 请您认真确认, 我司依据您回签后的图纸生产, 如图纸错误会产生不可估量损失, 我司免费! 谢谢! | |

受控文件